

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-028

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025年8月31日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司2026年3月15日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年9月2日、2026年3月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-041）、《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2026-019）。

2026年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕289号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于发行境外上市股份（H股）获中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-006）。

2026年6月4日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2026-026）。

根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108309/documents/sehk26061001512_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108309/documents/sehk26061001513.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026年6月11日